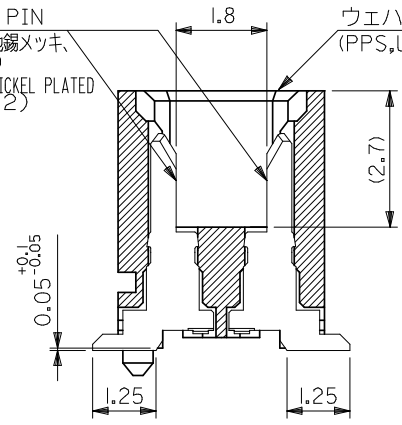


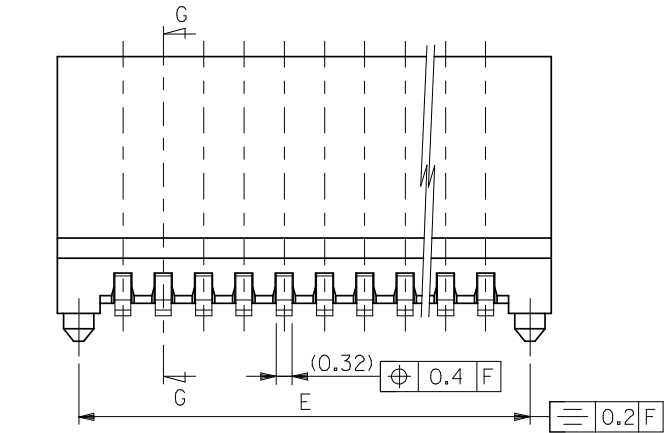
回路番号 1 (表示用切欠き)
CHAMFERING TO INDICATE CKT. NO.1

ピン PIN
(リン青銅、ニッケル下地銀メッキ、
 $t=0.32$)
(PHOS-BRO. TIN OVER NICKEL PLATED
 $t=0.32$)

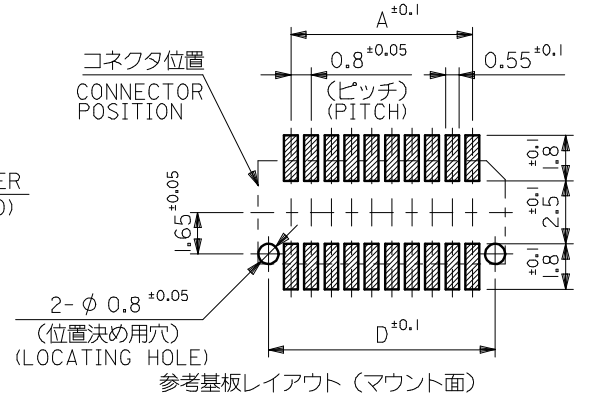
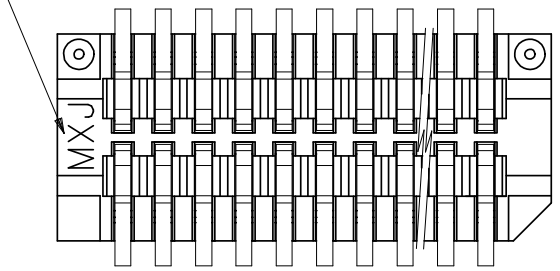
ウェハ WAFER
(PPS,UL94V-0)



SECT. G-G



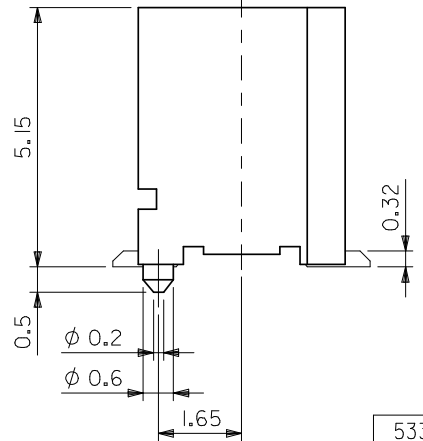
トレードマーク TRADE MARK



P.C.B. PATTERN LAYOUT (REF.) (MOUNT AREA)

注記 NOTES

1. 嵌合相手：52465 シリーズ
MATES WITH : 52465 SERIES
2. ウェハの ϕ から隣接するピンの ϕ 迄の位置を示す。
SHOW POSITION FROM ϕ OF WAFER TO ϕ OF ADJACENT PINS.
3. 本製品は 53364-**17 の鉛フリー品である。
THIS PRODUCT IS LEAD FREE OF 53364-**17



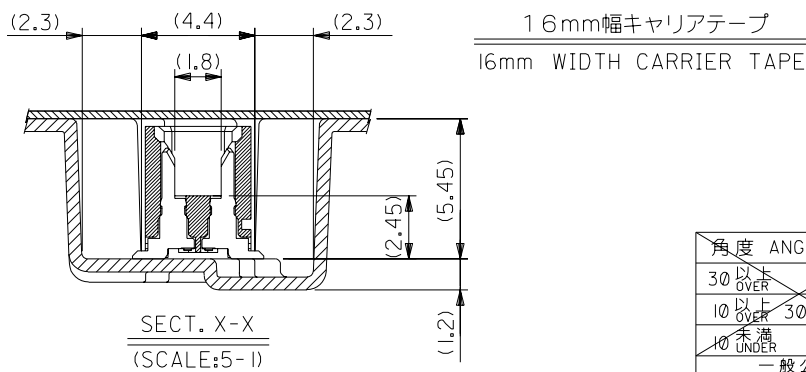
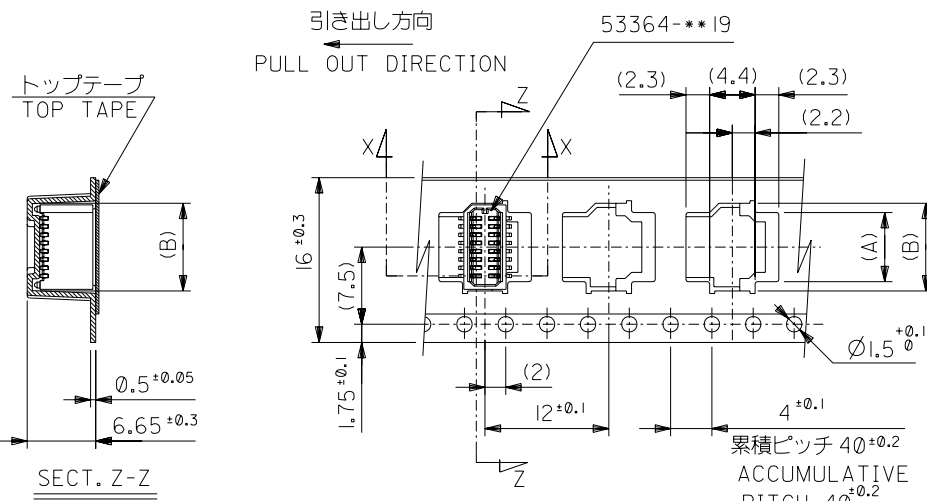
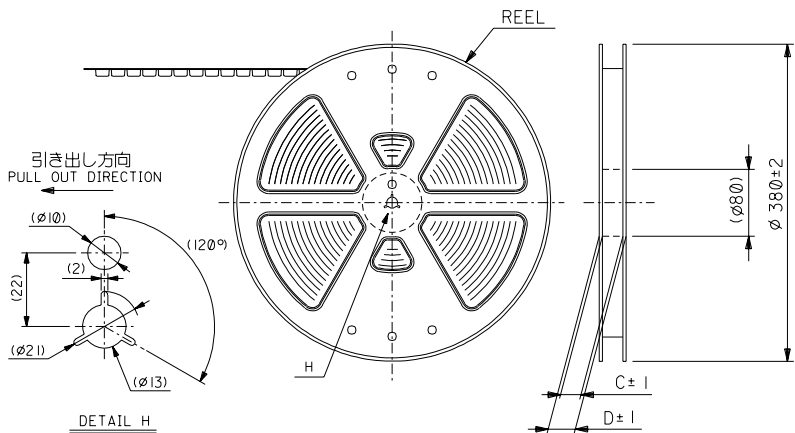
53364-**19
MODEL NO.

17.0	0.4	17.8	16.9	15.2	53364-4019	40
15.4	0.4	16.2	15.3	13.6	53364-3619	36
13.0	0.8	13.8	12.9	11.2	53364-3019	30
12.2	0.4	13.0	12.1	10.4	53364-2819	28
9.0	0.4	9.8	8.9	7.2	53364-2019	20
8.2	0.8	9.0	8.1	6.4	53364-1819	18
5.8	0.4	6.6	5.7	4.0	53364-1219	12
5.0	0.8	5.8	4.9	3.2	53364-1019	10
	E	D	C	B	A	MATERIAL NO. 極数 CKT.

REVISED	EC NO. J2008-3931	2008/05/26
	DRWN: MAKURAA	2008/05/26
	CHKD: T. HARIYAMA	2008/05/26
	APPR: NUKITA	2008/08/21
DESCRIPTION	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)	
REV	10 UNDER	±0.2
A	10 OVER 30 UNDER	±0.25
	30 OVER	±0.3
	ANGULAR	±3 °
	DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS	

DIMENSION STYLE MM ONLY		SCALE ---	DESIGN UNITS METRIC	THIRD ANGLE PROJECTION
DRAWN BY M. NABEI	DATE	TITLE 0.8 BOARD TO BOARD CONN. WAFER ASS ST.SMT -LEAD FREE-		
CHECKED BY K. TOJO	DATE	MOLEX INCORPORATED		
APPROVED BY M. SASAO	DATE	DOCUMENT NO. SD-53364-001	SHEET NO. 1 OF 1	
MATERIAL NO.	SEE TABLE			
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION				

DWG. NO. SD-53364-002
 DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING



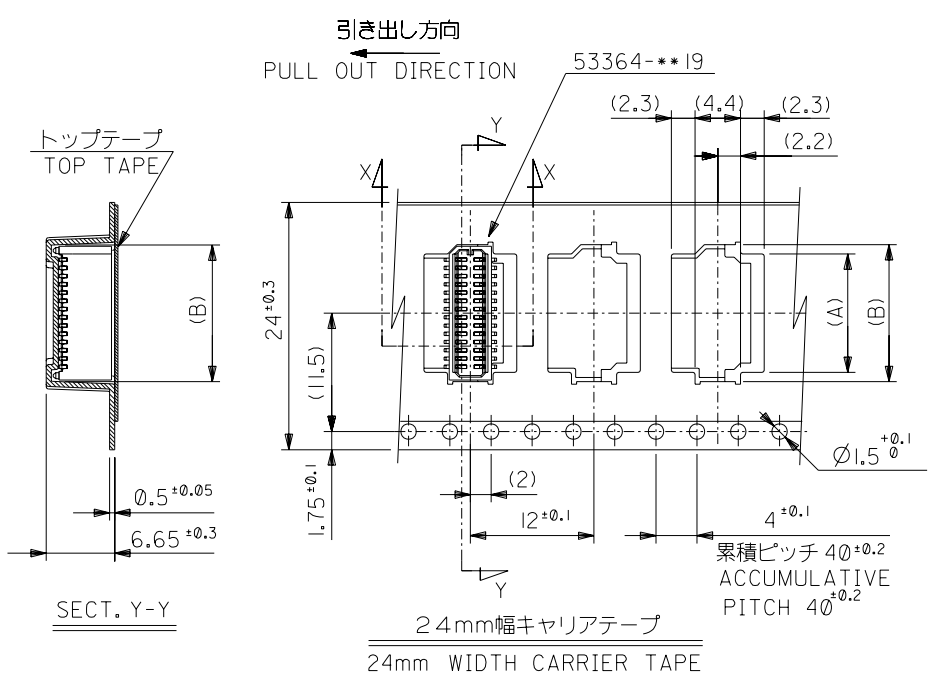
注記 NOTES

- 梱包数量：1000個/リール NUMBER OF CONNECTORS:1000PCS/REEL
- リードテープ長さ LEAD TAPE LENGTH
 トップテープ TOP TAPE
 リーダー部 LEADER PART
 トップテープ TOP TAPE
 未接着部 NON-BONDED PART
 175 ±25
 25 ±5
 引き出し方向 PULL OUT DIRECTION
 リーダー部 (空部) LEADER PART (EMPTY) 120 ±20
 部品挿入部 COMPONENT SUPPLIER
 末端部 (空部) TAIL PART (EMPTY) 150 ±40
 引き出し方向 PULL OUT DIRECTION
- トップテープの剥離強度：(剥離方向は下図参照)
 0.1~1.3N (10~130gf) 尚、本規格値は、出荷時に適用。
 (但し、輸送時に剥離が発生しない事。)
 PEELING OFF FORCE OF TOP TAPE
 0.1~1.3N (10~130gf) (PEELING DIRECTION AS SHOWN IN FOLLOWING FIG.)
 THIS REQUIREMENT SHOULD BE APPLIED AT SHIPMENT
 PEEL OFF SHOULD NOT BE ALLOWED,
 DURING TRANSPORTATION
 引き出し方向 PULL OUT DIRECTION
 剥離方向 PEEL OFF DIRECTION
 10°
- 材料 MATERIAL
 キャリアテープ：ポリプロピレン (PP) CARRIER TAPE:POLYPROPYLENE
 トップテープ：PET, PE, PEF TOP TAPE:PET,PE,PEF
 リール：ポリスチレン (PS) REEL:POLYSTYRENE(PS)
 <リサイクル材を含む> <RECYCLE MATERIAL CONTAINED>
- 本製品は 53364-**-90 の鉛フリー品である。
 THIS PRODUCT IS LEAD FREE OF 53364-**-90

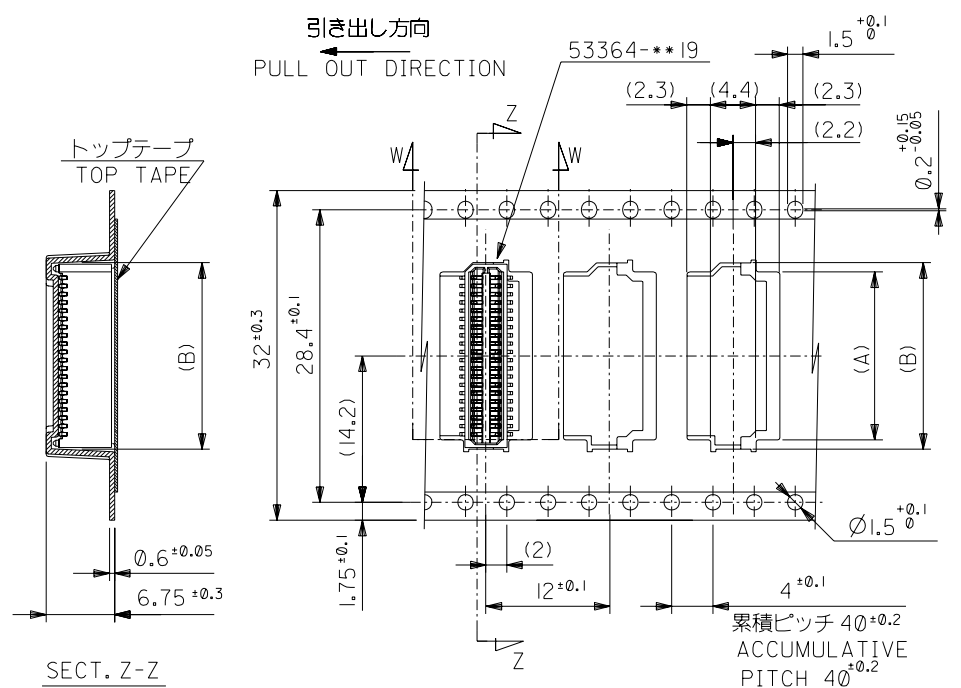
角度 ANGLE	±3°
30 以上 OVER	±0.3
10 以上 30 未満 UNDER	±0.25
未満 10 UNDER	±0.2
一般公差 GENERAL TOLERANCES	

53364-**-70 MODEL NO.	キャリアテープ幅 CARRIER TAPE WIDTH	16	21.4	17.4	9.3 6.9 6.1	7.5 5.1 4.3	53364-1870 53364-1270 53364-1070	18 12 10	MATERIAL NO.	極数 CIRCUIT
材料 MATERIAL 注記参照 SEE NOTES										
仕上げ FINISH —#—										
適用電線範囲 WIRE RANGE —#—										
被覆外径 INS. RANGE —#—										
0 新規作成 (1/2004-2950) RELEASED	M.N. M.S	04/03/09	DRAWN BY 04/03/09 M.NABEI			CHK'D BY 04/03/09 K.TOJO			MATERIAL NO. 極数	
記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR. CHK.	日付 DATE	APP'D BY 03/04/09 M.SASAO	尺度 SCALE	DWG. NO. (SHEET 1 OF 2) SD-53364-002			REV 0	

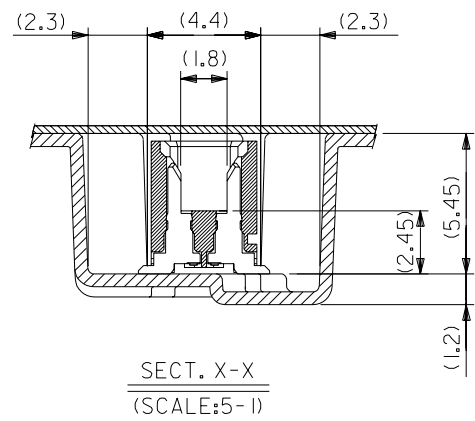
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
 本図面は日本モレックス(株)の所有する情報を含むもので 当社の許可なく複製を禁止する。



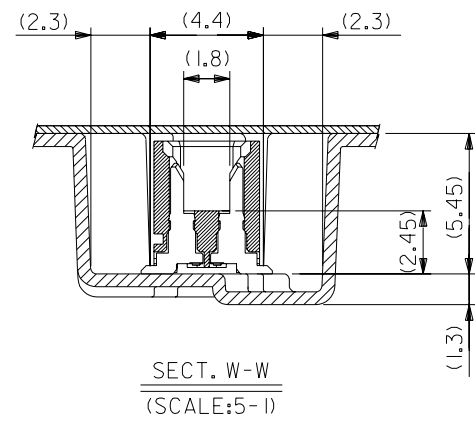
24mm幅キャリアテープ
24mm WIDTH CARRIER TAPE



32mm幅キャリアテープ
32mm WIDTH CARRIER TAPE



SECT. X-X
(SCALE:5-1)



SECT. W-W
(SCALE:5-1)

32	37.4	33.4	18.1	16.3	53364-4070	40
24	29.4	25.4	16.5	14.7	53364-3670	36
			14.1	12.3	53364-3070	30
			13.3	11.5	53364-2870	28
			10.1	8.3	53364-2070	20

53364-**-70	キャリアテープ幅	D	C	(B)	(A)	MATERIAL NO.	極数	
MODEL NO.	CARRIER TAPE WIDTH						CIRCUIT	
	材料	MATERIAL					MOLEX	MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社
	仕上げ	FINISH						
	適用電線範囲	WIRE RANGE					REVISE ONLY ON CAD SYSTEM	
	被覆外径	INS. RANGE					TITLE 名称	
	記号	新規作成	M.N.	04/03/09	DRAWN BY	CHK'D BY	0.8 BtB Conn Wafer Assy ST SMT With Boss Embstp Pkg -LEAD FREE-	
	LTR	変更内容	DR.	日付	APP'D BY	尺度	DWG. NO. (SHEET 2 OF 2) REV	
	一般公差	REVISION RECORD	CHK.	DATE	M.SASAO	SCALE	SD-53364-002 0	

角度	ANGLE	±30
30以上	OVER	±0.3
10以上	未満	±0.25
10以下	30以下	±0.2
未満	10以下	±0.2
GENERAL TOLERANCES		